

上海天玑科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措
施的承诺函

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：

一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

五、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

六、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

（本页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺函》之签字页）

全体董事签名：

陆文雄

姜蓓蓓

叶磊

杜力耘

楼晔

杨凯

黄钰昌

姚宝敬

徐宇舟

非董事高级管理人员签名：

陆廷洁

2016 年 4 月 18 日